
证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2026-041



深圳明阳电路科技股份有限公司

Sunshine Global Circuits Co., Ltd.

(深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋)

向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年六月

第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”、“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含 120,000.00 万元）（以下简称“本次发行”）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向不特定对象发行可转债募集资金运用的可行性说明如下：

一、本次募集资金投资使用计划

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 120,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目	119,982.72	99,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款项目	21,000.00	21,000.00
合计		140,982.72	120,000.00

本次发行募集资金总额为 120,000.00 万元，扣除发行费用后，计划 99,000.00 万元用于年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目，21,000.00 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款项目。

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金投资项目具体情况

（一）年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目

1、项目概况

公司拟在广东省珠海市富山工业园区建设年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目，项目实施主体为公司全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”），项目建设期为 2 年。项目建成后，将新增年产 10 万平方米人工智能高阶 HDI 算力产品，有效匹配 AI 数据中心及 AI 服务器行业的市场需求，进一步抢占高端市场份额，提高公司在印制电路板行业竞争力。

2、项目投资概算

单位：万元

序号	项目	项目投资金额	占总投资额比例
一	建设投资	118,441.96	98.72%
1	场地投入	31,254.79	26.05%
1.1	基础建设	6,596.29	5.50%
1.2	装修及工程投入	24,658.50	20.55%
2	设备投入	81,547.08	67.97%
3	基本预备费	5,640.09	4.70%
二	铺底流动资金	1,540.76	1.28%
三	项目投资总额	119,982.72	100.00%

3、项目建设的必要性

（1）契合下游市场需求，扩大高端产品生产能力

随着人工智能技术的深度渗透、数字经济的蓬勃发展及全球数据中心等基础设施建设的加速推进，高端服务器作为核心算力支撑，市场需求呈现爆发式增长态势。据 Fortune Business Insights 统计，2025 年全球人工智能数据中心的市场规模已达到 177.3 亿美元，预计 2026-2034 年间将以 25.8% 的 CAGR 从 212.7 亿美元增长至 1,355.1 亿美元。人工智能数据中心的快速发展，也会带动 AI 服务器市场空间的快速扩充。据 Trend Force 数据显示，2024 年全球 AI 服务器出

货量较 2023 年增长 40%，达 165.5 万台，预计到 2026 年将增长至 241.3 万台，2022-2026 年复合增长率（CAGR）达 28.8%；国内市场方面，2022 年中国 AI 服务器市场出货量约达 28.4 万台，2025 年将达到 48.8 万台。

AI 数据中心及 AI 服务器行业的快速迭代与规模扩张，直接带动高阶 HDI 算力产品的市场规模持续扩容，行业发展前景广阔。有鉴于此，近年来，公司前瞻性布局 AI 数据中心及 AI 服务器领域相关产品，积极推进用于配套上述下游领域的高阶 HDI 产品研发与产业化，目前相关产品已进入小批量供货阶段。面对日益扩大的市场需求，公司现有产能已难以满足客户规模化采购需求，亟需通过本次扩产项目加大投入，扩大生产能力。

本次项目实施后，公司将新增高阶 HDI 算力产品年产 10 万平方米的生产能力，能够有效匹配 AI 数据中心及 AI 服务器行业的市场需求，进一步抢占高端市场份额，巩固行业地位。

（2）突破现有交付瓶颈，提升大批量供应能力

当前，公司在工艺水平、设备配置及人员配置方面的布局，主要聚焦于核心客户小批量打样及定制化需求的交付，已形成成熟的小批量生产服务体系，能够满足客户在产品研发阶段的样品测试及验证需求。

但随着下游客户产品定型后进入规模化量产阶段，对公司的大批量稳定交付能力提出了更高要求。公司现有生产设备在精密加工精度、自动化生产效率等方面难以完全适配大批量生产需求，高端技术人才储备亦需进一步补充，生产工艺能力也需进一步提升。为持续深化与核心客户的合作关系，增强客户供应保障能力，公司亟需通过本次项目配置高端生产设备，引进高端技术人才，优化生产工艺流程，提升工艺精细化水平，从而突破小批量生产的局限，显著提升高阶 HDI 算力产品的大批量交付能力，满足下游客户的规模化采购需求。

（3）优化产品结构，增强盈利能力

从公司现有产品结构来看，目前业务涵盖多层板、HDI 板、刚柔结合板等多元化 PCB 产品，应用领域覆盖工业控制、汽车电子、消费电子等多个场景，但

高附加值产品的营收占比仍有提升空间，产品结构有待进一步优化。

本项目聚焦的高阶 HDI 算力产品，主要应用于数据中心及高端服务器场景，其生产制造涉及高阶 HDI 技术、高密度互连技术、高频高速信号传输技术等多项核心工艺，技术壁垒高，行业准入门槛高，相较于传统 PCB 产品，具有更高的技术附加值和产品单价。

通过本项目的实施，公司将大幅扩大高阶 HDI 算力产品等高端产品的生产规模，提高高附加值产品在整体营收中的占比，进一步优化产品结构，降低传统产品市场波动带来的经营风险，同时借助高端产品的高毛利特性，提升公司整体盈利水平和综合盈利能力。

4、项目建设的可行性

(1) 国家产业政策支持为本项目实施提供良好的政策环境

近年来，我国聚焦电子信息产业高端化、自主化发展，为此有关部门密集出台一系列产业政策。

2025 年 12 月，工业和信息化部等八部门发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，指出“支持突破高端训练芯片、端侧推理芯片、人工智能服务器、高速互联、智算云操作系统等关键技术。”；2025 年 8 月，国务院发布《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，指出“支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。”；同年，工业和信息化部、市场监督管理总局发布《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》，指出“推进人工智能服务器、高效存储等先进计算系统建设”、“加强 CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同等攻关力度”。此外，《印制电路板行业规范条件》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《数字中国建设整体布局规划》《制造业可靠性提升实施意见》《算力基础设施高质量发展行动计划》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等产业政策多维度、多层次为本行业及下游应用领域构建起系统完备、协同联动、导向明确的政策支撑体系。

(2) 专业的技术能力为本项目实施提供技术保障

作为深耕 PCB 行业二十余年的高新技术企业，公司始终以“技术立企”为核心发展战略，构建了全方位、多层次的技术研发体系。在研发组织建设方面，公司设立专业技术中心统筹核心技术研发与创新，下设多个专项研发小组，研发人员多为行业资深专家，形成分工明确、协同高效的研发架构，凭借对前沿技术的敏锐洞察和丰富实践经验，持续推动技术迭代与产品升级，截至 2025 年 12 月 31 日，公司技术人员占比达 17.37%。

同时，公司组建了“广东省 5G 高密度互联 HDI 线路板工程技术研究中心”，与南方科技大学、中国科学院深圳先进技术研究院等知名院校共建联合实验室。公司多年来深耕技术创新，持续加大研发投入，形成了较为丰富的技术成果。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计获授权专利 112 项，其中发明专利 43 项，涵盖多层板精密制造、HDI 板互联技术、高频高速信号传输等多个核心领域。

针对本项目，公司已构建了从材料适配与选型、仿真设计与信号完整性到精密制程与工艺能力、性能验证与可靠性体系的完整技术体系。公司建立了高速材料数据库并应用 M7/EM892K 等低损耗材料，组建了 SI 仿真团队以满足 200G/400G/800G 及以上传输需求，同时掌握了多层压合等关键工艺，搭建了全流程性能验证与可靠性测试机制。

此外，公司形成了攻克背钻、16 层任意层 HDI、±7%精准阻抗控制及沉金表面处理等成熟工艺方案，充分满足高端服务器 PCB 在高密度互联、高速传输、高可靠性等方面的要求，为项目实施提供技术保障。

(3) 良好的品牌形象和稳定的客户资源，为项目的实施提供了市场基础

经过多年的国际市场开拓和品牌经营，公司凭借稳定的产品质量、高效的交付能力及优质的服务水平，在全球小批量板市场领域树立了良好的品牌形象与行业知名度，获得了市场与客户的广泛认可。公司客户整体质量高，多为国内外上市公司或细分行业龙头企业，已与 Flex（伟创力）、Jabil（捷普）、ENICS（艾尼克斯）、Plexus（贝莱胜）等全球知名企业建立长期稳定的合作关系，客户覆

盖工业控制、医疗健康、汽车电子、半导体、人工智能、数据中心等多个核心领域。

为大力发展 AI 数据中心及服务器用 PCB 业务，公司成立了 AI 事业部，储备了一批经验丰富的大客户拓展服务团队，并在客户拓展方面成果显著，已与海康威视、迈普、恒为、飞腾等建立了良好的合作关系。

(4) 丰富的生产与质量管理经验为本项目提供了管理保障

公司专注于小批量 PCB 产品制造，针对“小批量、多品种、定制化”的产品特征，构建了完善的生产管理体系和柔性化生产管理模式，能够及时响应客户纷繁多样的产品需求。

公司高度重视产品品质管理，建立了覆盖原材料采购、生产制程控制、成品检测等全流程的质量管理体系，通过了 ISO9001、IATF16949、ISO3485、ISO14001、ISO45001、ISO50001 等多项权威质量和管理体系认证，以及 UL、CQC 等产品安全认证。

此外，公司通过开展“百日攻坚”降本增效行动、聚焦“三横三纵一突破”项目、深化 SAP、IMS、SRM 等系统应用场景等方式，持续优化供应链管理、提升运营效率及产品良率，为本项目的高效运营提供了成熟的管理模式支撑。

5、项目经济效益分析

本项目建设期 2 年，本项目达产后预计所得税后财务内部收益率为 12.46%，税后静态投资回收期（含建设期）为 7.04 年，项目经济效益良好。

6、项目审批备案情况

本项目实施地点为广东省珠海市富山工业园区，公司已取得项目建设地所属地块的国有土地使用权证，其余审批备案程序正在有序办理中。

(二) 补充流动资金及偿还银行贷款项目

公司所处行业为技术、人才密集型行业，强大的技术研发能力是公司保持市

市场竞争力与行业地位的关键。伴随本次其他募投项目的推进，未来公司将持续专注于 PCB 行业，不断推出新产品，加大高端人才培养与引进力度，维持公司的核心技术优势。因此，公司未来运营资金需求会不断增长。

公司本次拟使用 21,000.00 万元募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，以支持公司主营业务发展，提升持续经营能力和盈利水平，这将有效降低公司的财务运营成本，进一步提升整体盈利水平，增强公司竞争实力，增强公司长期可持续发展能力。

三、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，符合公司主营业务发展方向，具有良好的市场前景和经济效益。

本次募集资金投资项目的实施，将切实提升公司生产能力、市场地位和经营能力，促进公司主营业务进一步发展，提高公司的盈利能力，增强市场竞争力，同时提升公司的抗风险能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司资本实力，有利于提升公司抗风险能力。本次发行募集资金到位后，由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降；但募集资金投资项目投产后，随着项目效益的逐步显现，公司的规模扩张和利润增长将逐步实现，经营活动现金流入将逐步增加，净资产收益率及每股收益将有所提高，公司核心竞争力、行业影响力和可持续发展能力将得到增强。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目与公司

主营业务相关，符合国家产业政策和公司发展的需要，具有必要性及可行性。公司投资项目所涉及产品的市场潜力较大，募集资金项目达产后将会提高公司的运营效率、提升公司综合竞争能力，从而增强公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月6日